

Group Up Industrial Co., Ltd. Earnings Conference 群翊工業股份有限公司

Date 2026.03.30

報告順序

- | | | |
|--------------------------|------------------|------------|
| 1. Spokesperson | : Mr. Bill Yu | 余添和 發言人 |
| 2. CFO | : Ms. Wendy Shen | 沈錦味 財務長 |
| 3. Senior Sales Manager: | Mr. Brent Lee | 李志宏 營業副總經理 |
| 4. Deputy Spokesperson: | Mr. Ray Hung | 洪健庭 代理發言人 |

TO INNOVATE THE TECHNOLOGY, TO LEAD THE MARKET
TO KEEP EXCELLENT SERVICE, TO EARN TRUST

 群翊
GROUP

 36
Year ANNIVERSARY

No. 188, Heping Road, Yangmei District, Taoyuan City 326
T +886-3-4851536 | www.gp-line.com

免責聲明

本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、現在及未來之營運彙總與評估；其中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論所影響，部份將超出公司的控制之外，實際結論可能與這些前瞻性論述大為不同。

- 所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性；亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。
- 本簡報中對未來的展望，反應公司截至目前為止之看法。這些若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒及更新。

1

財務報告 Financial Report

TO INNOVATE THE TECHNOLOGY, TO LEAD THE MARKET
TO KEEP EXCELLENT SERVICE, TO EARN TRUST

群翔
GROUP

36
Year ANNIVERSARY

No. 188, Heping Road, Yangmei District, Taoyuan City 326
T +886-3-4851536 | www.gp-line.com

1-1年簡明財務報表Financial Statements

| 期 別 Period | | 單位：新台幣仟元 Unit: New Taiwan Dollar in Thousand | | | |
|---|---|--|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | | 114年度 FY2024 | 113年度 FY2024 | 變動金額 Difference Amount | 變動比率 Change ratio |
| 簡明資產負債 Balance Sheet | 資產總計 Total Assets | 8,896,252 | 8,579,732 | 316,520 | 4% |
| | 負債總計 Total Liabilities | 4,649,642 | 4,696,347 | (46,705) | -1% |
| | 權益總計 Total Stockholders and Equity | 4,246,610 | 3,883,385 | 363,225 | 9% |
| | 每股淨值(元) Net Value Per Share (New Taiwan Dollar) | 69.84 | 64.51 | 5.33 | 8% |
| 簡明綜合損益表 Statements of Comprehensive Income | 營業收入 Operating Revenues | 2,574,456 | 2,497,759 | 76,697 | 3% |
| | 營業利益(損失) Operating Gains (Losses) | 1,020,249 | 930,120 | 90,129 | 10% |
| | 稅前淨利(淨損) Gains (Losses) Before Tax | 1,137,052 | 1,241,249 | (104,197) | -8% |
| | 基本每股盈餘(元) Basic Earnings Per Share (New Taiwan Dollar) | 15.06 | 16.97 | (1.91) | -11% |
| 簡明現金流量表 Statements of Cash Flows | 營業活動之淨現金流入(流出) Net Cash Flows From Operating Activities | 715,874 | 976,183 | (260,309) | -27% |
| | 投資活動之淨現金流入(流出) Net Cash Flows Used In Investing Activities | (729,310) | (1,392,305) | 662,995 | -48% |
| | 籌資活動之淨現金流入(流出) Net Cash Flows Used In Financing Activities | (606,671) | 864,623 | (1,471,294) | -170% |

1-2.資產負債表Consolidated Balance Sheets

| | 單位：新台幣仟元 Unit: New Taiwan Dollar in Thousands | | | | | |
|--|---|---------------|------------------------|---------------|----------------|-----------|
| | 114.12.31 (2025.12.31) | | 113.12.31 (2024.12.31) | | Difference | |
| | 金額 Amount | % | 金額 Amount | % | 金額 Amount | % |
| 資產 Assets | | | | | | |
| 流動資產合計 Total current assets | 7,307,492 | 82.14 | 6,919,893 | 80.65 | 387,599 | 6% |
| 非流動資產合計 Total non-current assets | 1,588,760 | 17.86 | 1,659,839 | 19.35 | (71,079) | -4% |
| 資產總計 Total assets | 8,896,252 | 100.00 | 8,579,732 | 100.00 | 316,520 | 4% |
| 現金及約當現金+金融資產 Cash and cash equivalents+Financial assets | 5,392,390 | 60.61 | 5,251,396 | 61.21 | 140,994 | 3% |
| 應收款項 Accounts receivable | 370,630 | 4.17 | 425,947 | 4.96 | (55,317) | -13% |
| 存貨 Inventories | 1,774,234 | 19.94 | 1,527,749 | 17.81 | 246,485 | 16% |
| 不動產、廠房及設備 Property, plant and equipment | 1,201,507 | 13.51 | 1,216,070 | 14.17 | (14,563) | -1% |

1-2. 資產負債表 Consolidated Balance Sheets

| | 單位：新台幣仟元 Unit: New Taiwan Dollar in Thousands | | | | | |
|--|---|--------|------------------------|--------|--------------|------|
| | 114.12.31 (2025.12.31) | | 113.12.31 (2024.12.31) | | Difference | |
| | 金額 Amount | % | 金額 Amount | % | 金額 Amount | % |
| 負債及權益 Liabilities and equity | | | | | | |
| 流動負債： | | | | | | |
| 流動負債合計 Total current liabilities | 3,374,803 | 37.94 | 3,433,946 | 40.02 | (59,143) | -2% |
| 非流動負債合計 Total non-current liabilities | 1,274,839 | 14.33 | 1,262,401 | 14.71 | 12,438 | 1% |
| 負債總計 Total liabilities | 4,649,642 | 52.27 | 4,696,347 | 54.74 | (46,705) | -1% |
| 合約負債 Contract liabilities | 2,616,554 | 29.41 | 2,864,640 | 33.39 | (248,086) | -9% |
| 應付帳款 Accounts payable | 379,544 | 4.27 | 141,475 | 1.65 | 238,069 | 168% |
| 應付可轉換公司債 Convertible bonds payable | 1,200,558 | 13.50 | 1,225,283 | 14.28 | (24,725) | -2% |
| 權益總計 Total equity | 4,246,610 | 47.73 | 3,883,385 | 45.26 | 363,225 | 9% |
| 負債及權益總計 | 8,896,252 | 100.00 | 8,579,732 | 100.00 | 316,520 | 4% |

1-3. 綜合損益表 Consolidated Statement of Comprehensive Income



| | 單位：新台幣仟元 Unit: New Taiwan Dollar in Thousands | | | | | |
|---|---|------|--------------|------|--------------|------|
| | 114年度 FY2025 | | 113年度 FY2024 | | Difference | |
| | 金額 Amount | % | 金額 Amount | % | 金額 Amount | % |
| 營業收入淨額 Net sales revenue | 2,574,456 | 100% | 2,497,759 | 100% | 76,697 | 3% |
| 營業成本 Operating costs | 1,061,886 | 41% | 1,198,982 | 48% | (137,096) | -11% |
| 營業毛利 Gross profit from operations | 1,512,570 | 59% | 1,298,777 | 52% | 213,793 | 16% |
| 營業費用合計 Total operating expenses | 492,321 | 19% | 368,657 | 15% | 123,664 | 34% |
| 推銷費用 Selling expenses | 149,800 | 6% | 119,713 | 5% | 30,087 | 25% |
| 管理費用 Administrative expenses | 148,292 | 6% | 114,574 | 5% | 33,718 | 29% |
| 研究發展費用 Research and development expenses | 194,229 | 8% | 134,370 | 5% | 59,859 | 45% |

1-3. 綜合損益表 Consolidated Statement of Comprehensive Income



| | 單位：新台幣仟元 Unit: New Taiwan Dollar in Thousands | | | | | |
|---|---|-----|--------------|-----|--------------|-------|
| | 114年度 FY2025 | | 113年度 FY2024 | | Difference | |
| | 金額 Amount | % | 金額 Amount | % | 金額 Amount | % |
| 營業淨利 Net operating income | 1,020,249 | 40% | 930,120 | 37% | 90,129 | 10% |
| 營業外收入及支出合計 Total non-operating income and expenses | 116,803 | 5% | 311,129 | 12% | (194,326) | -62% |
| 利息收入 Interest income | 120,999 | 5% | 118,673 | 5% | 2,326 | 2% |
| 外幣兌換損益 Foreign exchange gains (losses) | (24,194) | -1% | 169,393 | 7% | (193,587) | -114% |
| 稅前淨利 Profit | 1,137,052 | 44% | 1,241,249 | 50% | (104,197) | -8% |
| EPS(元) (New Taiwan Dollar) | 15.06 | | 16.97 | | (1.91) | |
| EPS-本業(元) Operating | 13.51 | | 12.72 | | 0.80 | |
| EPS-業外(元) Non-operating | 1.55 | | 4.25 | | (2.71) | |

1-4.現金流量表 Consolidated Statement of Cash Flows



| | 單位：新台幣仟元 Unit: New Taiwan Dollar in Thousands | |
|--|---|--------------|
| | 114年度 FY2025 | 113年度 FY2024 |
| 本期稅前淨利 Profit before tax | 1,137,052 | 1,241,249 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) Net Cash Flows From Operating Activities | 715,874 | 976,183 |
| 應收款項 Accounts receivable | 56,251 | 43,736 |
| 存貨 Inventories | (246,485) | 369,904 |
| 合約負債 Contract liabilities | (248,086) | (466,679) |
| 應付帳款 Accounts payable | 238,069 | (65,313) |
| 支付所得稅 Income taxes paid | (276,177) | (172,006) |
| 投資活動之淨現金流入(流出) Net Cash Flows Used In Investing Activities | (729,310) | (1,392,305) |
| 金融資產 Financial assets | (712,457) | (776,137) |
| 取得不動產 Acquisition of property, plant and equipment | (13,513) | (617,559) |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) Net Cash Flows Used In Financing Activities | (606,671) | 864,623 |
| 發行公司債 Proceeds from issuance of convertible bonds | 0 | 1,332,085 |
| 發放現金股利 Cash dividends paid | (603,569) | (463,912) |
| 期末現金及約當現金餘額 Cash and cash equivalents at end of period | 519,683 | 1,124,468 |
| 期末金融資產餘額 Financial assets at end of period | 4,872,707 | 4,126,928 |
| 現金及約當現金+金融資產餘額 Cash and cash equivalents+Financial assets at end of period | 5,392,390 | 5,251,396 |

1-5. 股利發放情形 Dividend Distribution

| | 114年度 FY2025 | 113年度 FY2024 | 112年度 FY2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 本期淨利(新台幣仟元) Net Profit (New Taiwan Dollar in Thousands) | 913,868 | 999,614 | 713,560 |
| 每股稅後盈餘(新台幣元) Earnings Per Share After Tax (New Taiwan Dollar) | 15.06 | 16.97 | 12.65 |
| 每股稅後盈餘(新台幣元)-本業 EPS-Main business (New Taiwan Dollar) | 13.51 | 12.72 | 9.95 |
| 每股稅後盈餘(新台幣元)-業外 EPS-Outside of this business (New Taiwan Dollar) | 1.55 | 4.25 | 2.70 |
| 每股現金股利(新台幣元) Cash Dividend Per Share (New Taiwan Dollar in Thousands) | 10.20 | 10.00 | 8.00 |
| 現金股利發放比率 Cash Dividend Payout Ratio | 68% | 59% | 63% |
| 現金股利發放比率-本業 Cash Dividend Payout Ratio-Main business | 75% | 79% | 80% |
| 收盤平均價 Average Closing Price | 231.06 | 234.35 | 134.41 |
| 殖利率 Dividend Rate | 4.41% | 4.27% | 5.95% |

2 公司現況與市場展望

■ 公司現況

- 公司概要
- 組織架構
- 技術領域
- 產品介紹

■ 市場展望

- 市場趨勢
 - 印刷電路板
 - 半導體先進封裝
- 服務據點佈局



群翔
GROUP



36
Year ANNIVERSARY

No. 188, Heping Road, Yangmei District, Taoyuan City 326
T +886-3-4851536 | www.gp-line.com

公司概要



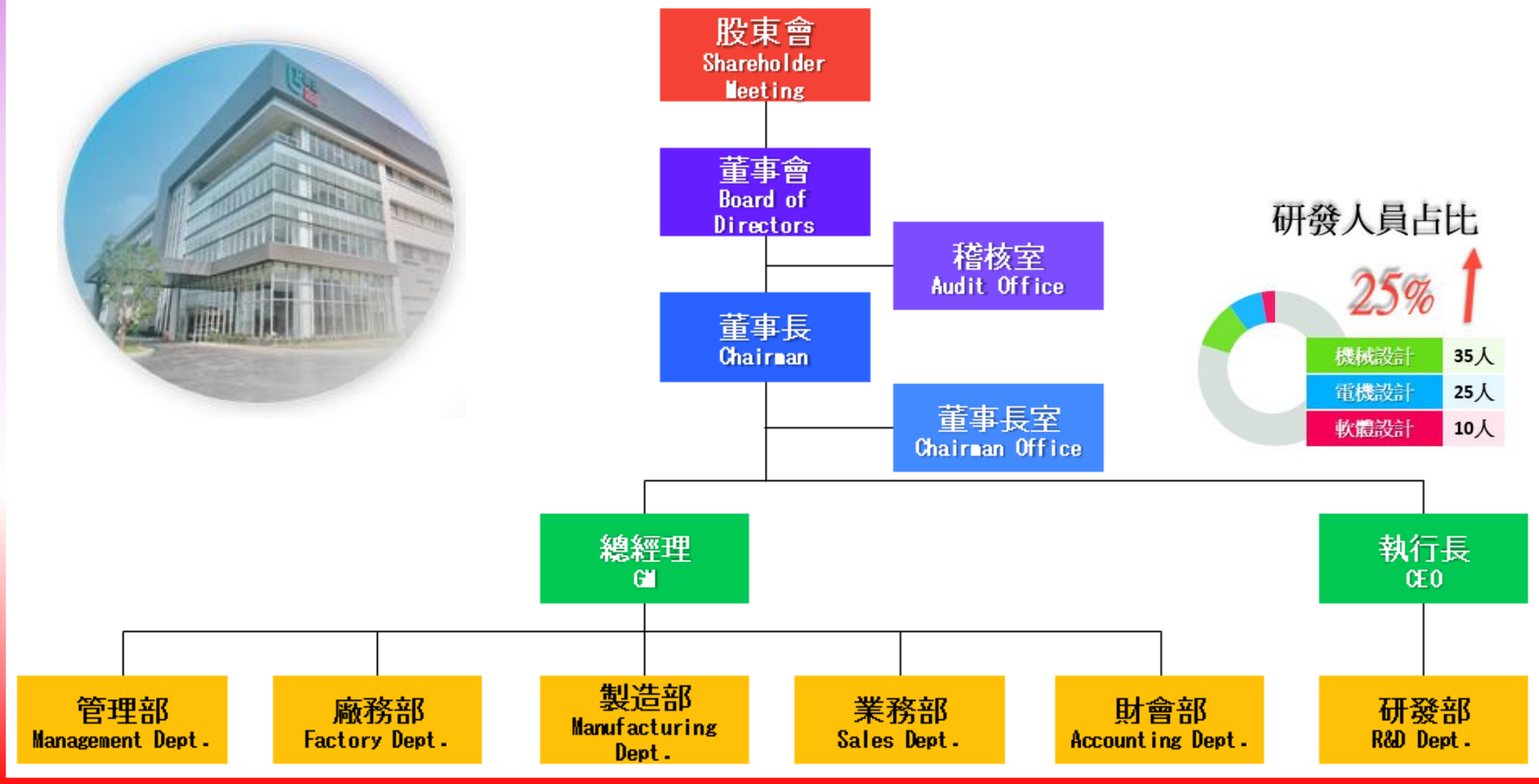
楊梅工廠
 基地：3800坪
 建築面積：6800坪
 從業人數：260人



蘇州工廠
 基地：55畝
 建築面積：28000平方米
 從業人數：140人

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 設立 | 1990年1月 |
| 資本額 | 台灣實收： 新台幣 6億元 大陸實收： 美金1仟萬元 |
| 營業額 | 2025年度營收： 新台幣 25.74億元 |

組織架構



技術領域



產品介紹



電路板、
載板製程設備



半導體、TGV、
先進封裝製程設備



顯示器、
光學製程設備



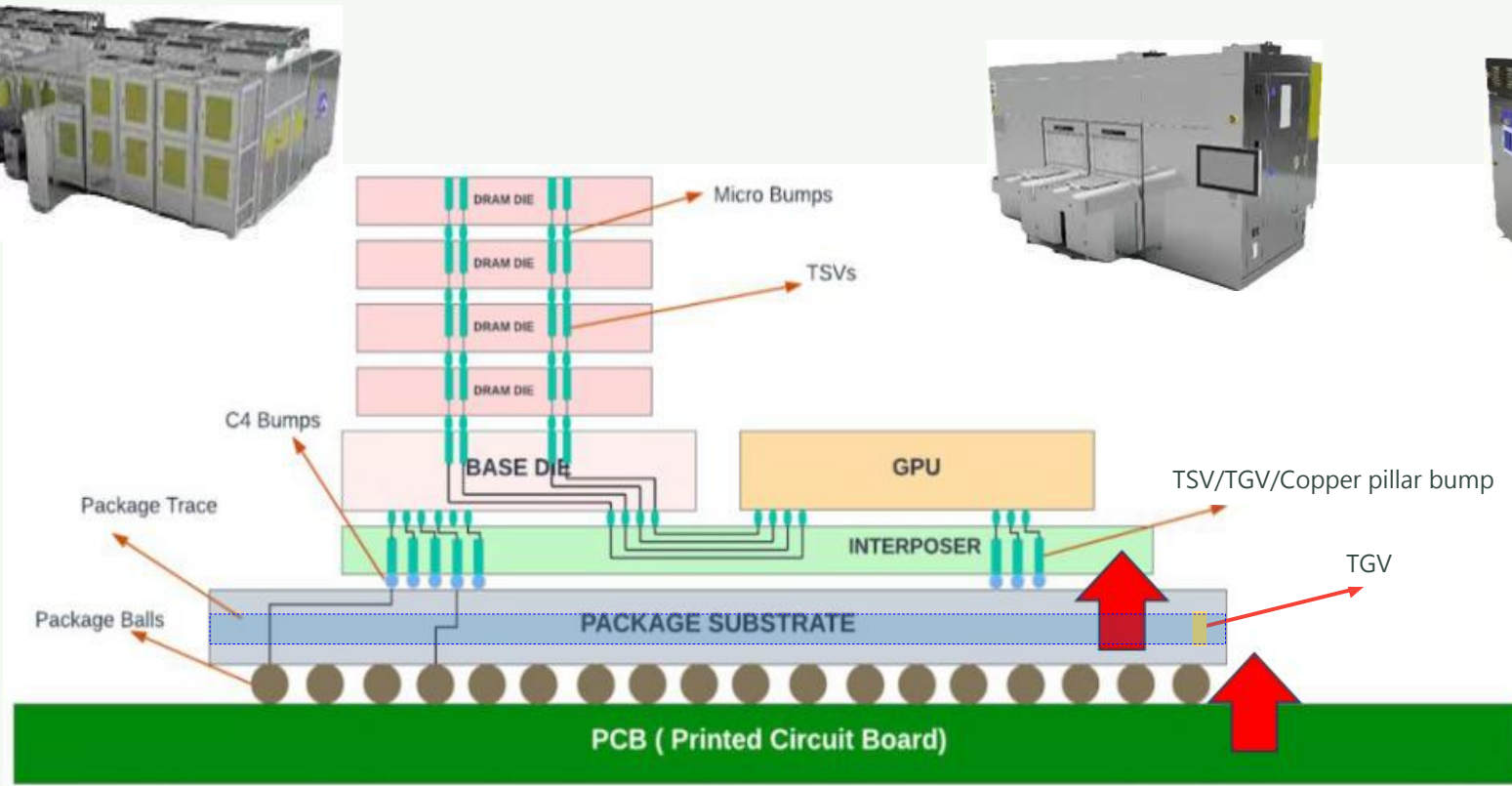
軟性電子、
捲對捲製程設備



自動化 Automation

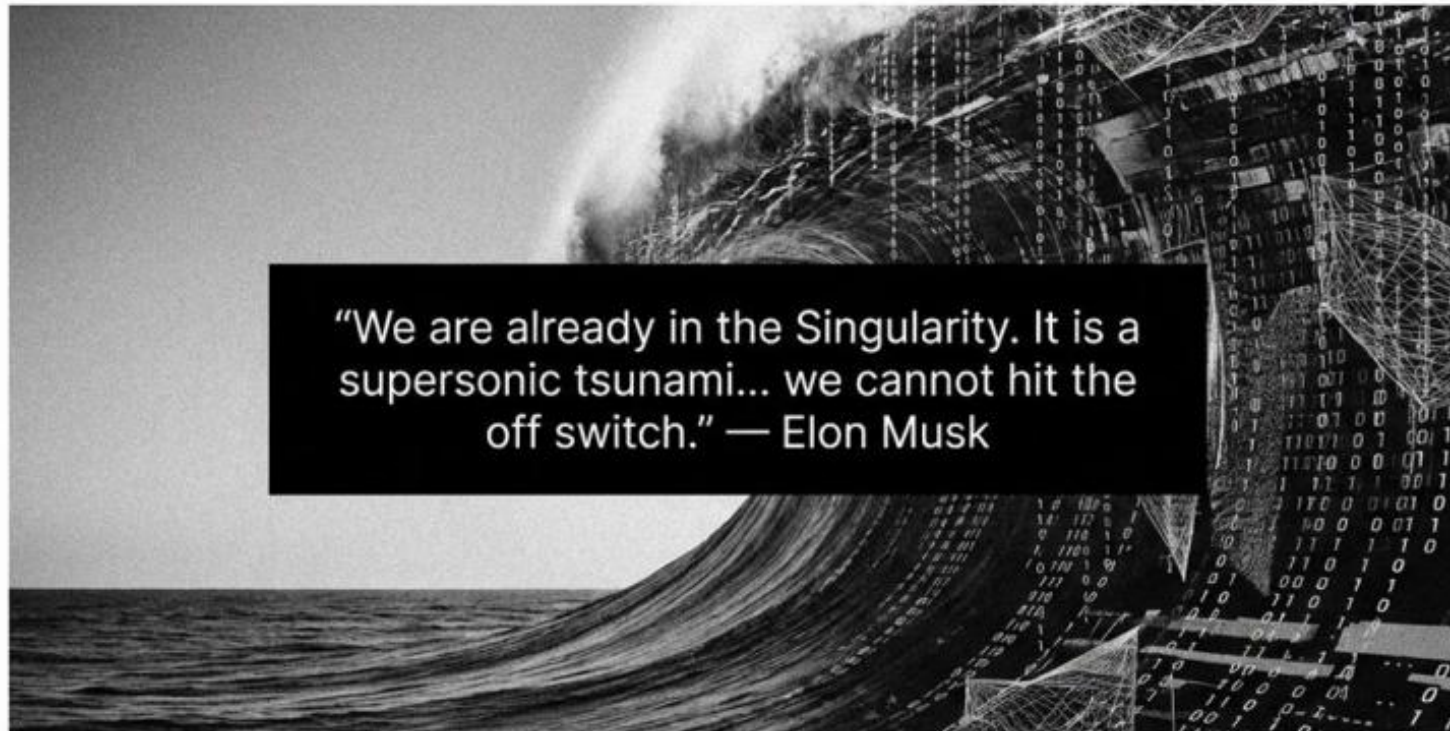


產品介紹



市場趨勢

THE SUPERSONIC TSUNAMI NAVIGATING THE 2026 SINGULARITY



EXECUTIVE SUMMARY

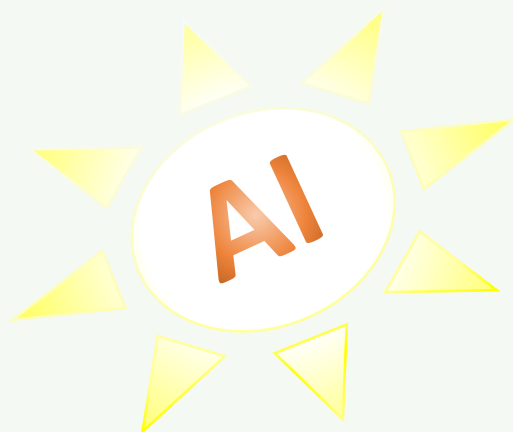
- **Thesis:** History has shifted from linear to exponential. Convergence of AI, Robotics, and Energy.
- **Stakes:** 2026 marks the arrival of AGI. The threshold of no return.
- **Trajectory:** Disruption of cognitive labor -> Universal High Income -> Multi-planetary expansion.

Elon Musk warns:
AI + robotics will hit us like a "supersonic tsunami."
2026/2/13

- **科技奇點 (Technology Singularity) :** 指人工智慧發展到超越人類智慧的時刻，導致人類文明發生不可逆轉的突變。

伊隆馬斯克警告：人工智慧+機器人技術將像「超音速海嘯」一樣席捲全球。

市場趨勢



Cloud



伺服器叢集和資料倉儲

- 儲存、管理和處理數據
- 應用程式和服務
- 人工智慧模型訓練
- 自然語言處理
- 生成式人工智慧

基礎建設需先建置

Edge




高效能 即時

- 極高的在地資料處理頻寬、平行性和記憶體容量
- 大量感測器
- 強大的電源
- 在某些情況下，散熱和占地面積方面存在挑戰

散熱和占地面積
存在挑戰

Endpoints



高效率 即時

三大黃金標準

- 體積極小化
- 密集型計算且有足夠資料儲存空間
- 供電電池微小化

單獨實現很容易
但要同時滿足三要項
非常困難

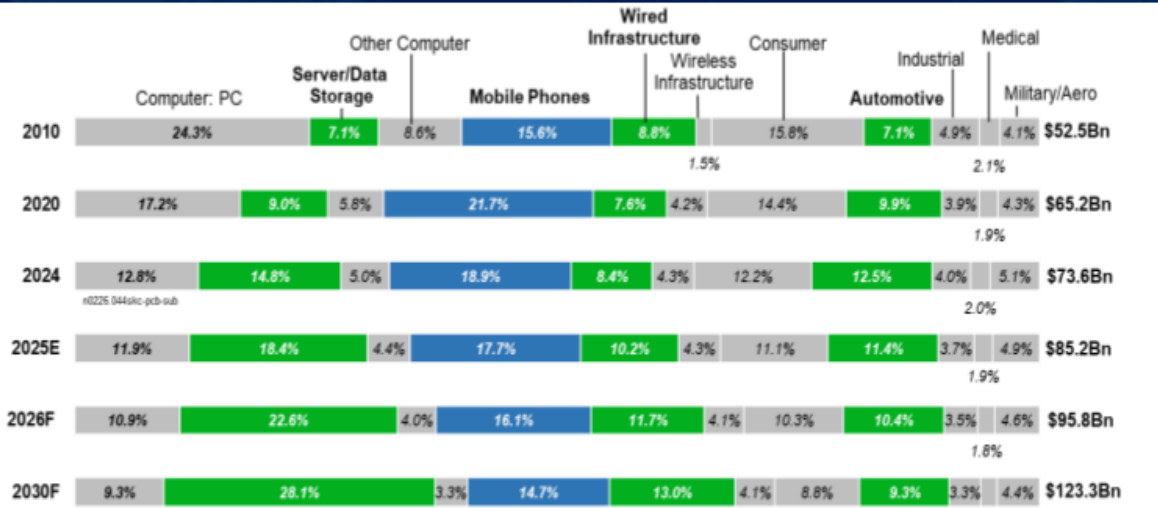


人類行為模式正在改變

市場趨勢

➤ 印刷電路板 & 載板

TOTAL PCB AND SUBSTRATE DEMAND BY APPLICATION



| \$M | 2020 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026F | 2030F | 2025E/2024 | 2025-2030F CAAGR |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|
| Computer: PC | \$11,210 | \$9,391 | \$9,429 | \$10,168 | \$10,460 | \$11,414 | 7.8% | 2.3% |
| Server/Data Storage | \$5,876 | \$8,201 | \$10,916 | \$15,675 | \$21,610 | \$34,679 | 43.6% | 17.2% |
| Other Computer | \$3,801 | \$3,661 | \$3,649 | \$3,777 | \$3,814 | \$4,119 | 3.5% | 1.7% |
| Mobile Phones | \$14,150 | \$13,085 | \$13,886 | \$15,046 | \$15,402 | \$18,189 | 8.4% | 3.9% |
| Wired Infrastructure | \$4,958 | \$5,955 | \$6,153 | \$8,664 | \$11,234 | \$16,076 | 40.8% | 13.2% |
| Wireless Infrastructure | \$2,771 | \$3,118 | \$3,177 | \$3,681 | \$4,007 | \$5,003 | 15.9% | 6.3% |
| Consumer | \$9,366 | \$9,129 | \$8,972 | \$9,475 | \$9,825 | \$10,871 | 5.6% | 2.8% |
| Automotive | \$6,457 | \$9,153 | \$9,195 | \$9,717 | \$9,931 | \$11,416 | 5.7% | 3.3% |
| Industrial | \$2,543 | \$2,871 | \$2,918 | \$3,158 | \$3,341 | \$4,053 | 8.2% | 5.1% |
| Medical | \$1,263 | \$1,440 | \$1,500 | \$1,639 | \$1,725 | \$2,041 | 9.3% | 4.5% |
| Military/Aerospace | \$2,824 | \$3,514 | \$3,770 | \$4,153 | \$4,432 | \$5,486 | 10.1% | 5.7% |
| Total | \$65,218 | \$69,517 | \$73,565 | \$85,152 | \$95,780 | \$123,348 | 15.8% | 7.7% |

Server / Data Storage
Wired Infrastructure

Wireless Infrastructure
Military/Aerospace

Medical
Automotive
Mobile Phones

Consumer
Computer: PC



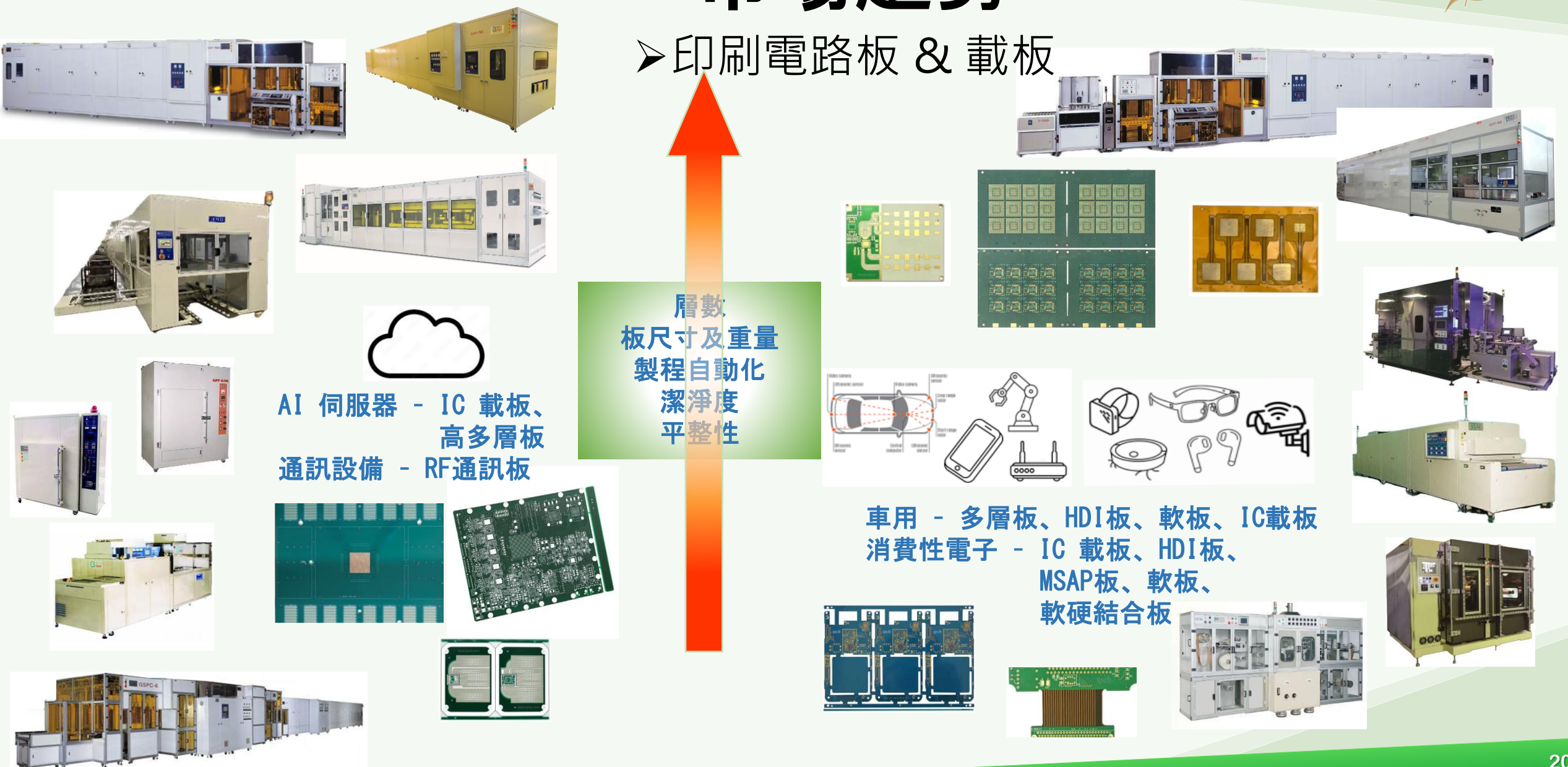
市場趨勢

印刷電路板 & 載板

層數
板尺寸及重量
製程自動化
潔淨度
平整性

AI 伺服器 - IC 載板、高多層板
通訊設備 - RF通訊板

車用 - 多層板、HDI板、軟板、IC載板
消費性電子 - IC 載板、HDI板、MSAP板、軟板、軟硬結合板



市場趨勢

➤ 半導體先進封裝

晶圓/板 級封裝
**Wafer/Panel
 Level
 Packaging**

&

異質整合
**Heterogeneous
 Integration**

先進封裝
**Advanced
 Packaging**

玻璃核心載板
**Glass Core
 Substrate**

&

玻璃中介層
**Glass
 Interposer**

群翔設備 v. s. 先進封裝



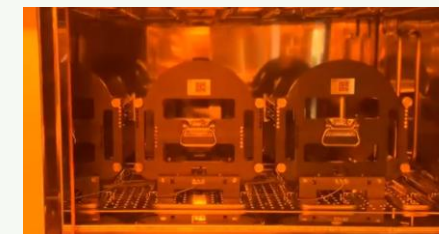
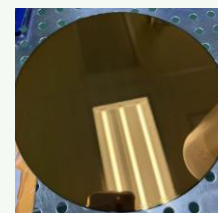
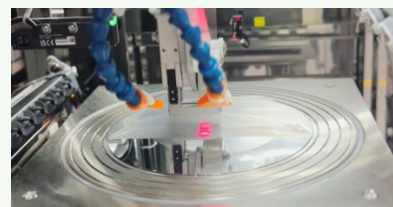
市場趨勢

➤ 半導體先進封裝

群翔晶圓設備



貼+壓



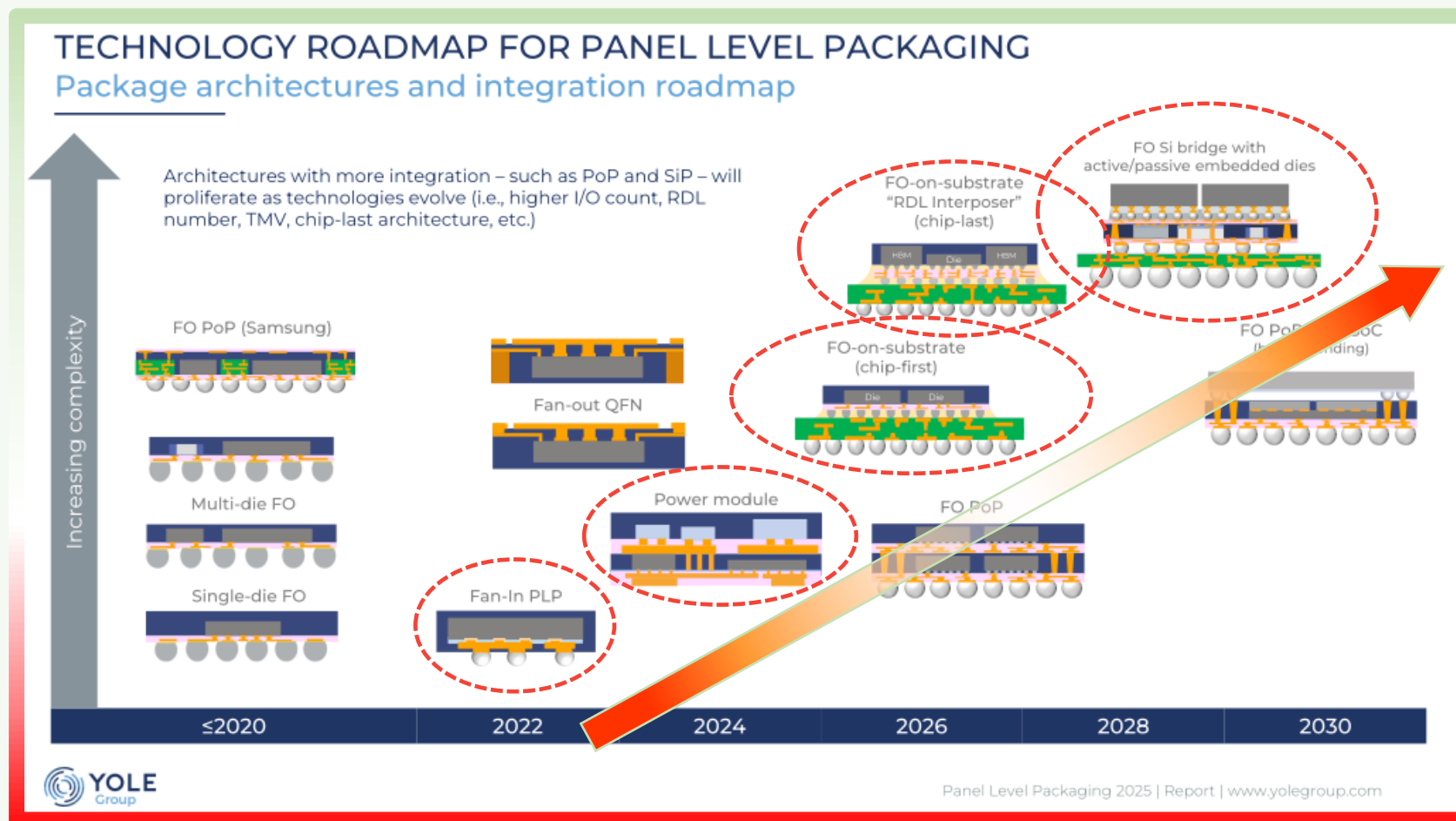
撕

塗

烤

市場趨勢

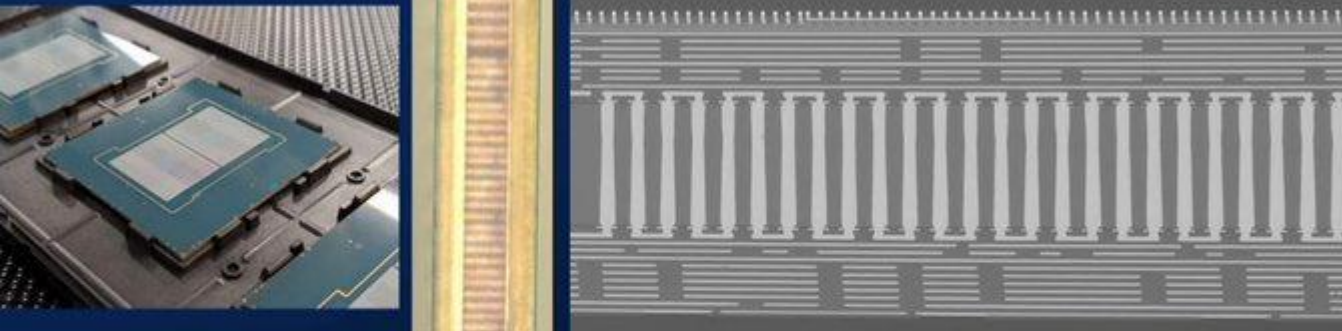
➤ 半導體先進封裝-PLP



市場趨勢

➤ 半導體先進封裝-Glass Core

Industry First 10-2-10 Thick Glass core substrate with EMIB!



The image shows three views of the Intel glass core substrate: a top-down view of the package, a side view showing the EMIB bridges, and a microscopic view of the bump pitch.

- 78mmX 77mm package
- ~2x Reticle in Si content
- 800 um Glass Core Substrate
- No SeWaRe
- 2 EMIB bridges
- 45um bump pitch

Glass Core Substrate with EMIB for data centric applications fabricated – Assembly & Reliability underway

intel foundry 2026 NEPCON

已看到市場曙光
以及關注中Tier 1廠商身影

已看到市場曙光
以及關注中Tier 1廠商身影

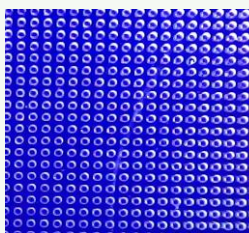
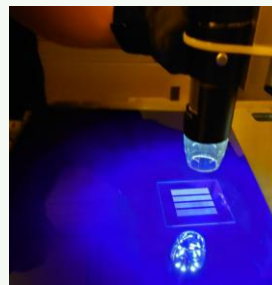
Intel' s glass core substrate unveiled at NEPCON Japan 2026

市場趨勢

➤ 半導體先進封裝-Glass Core



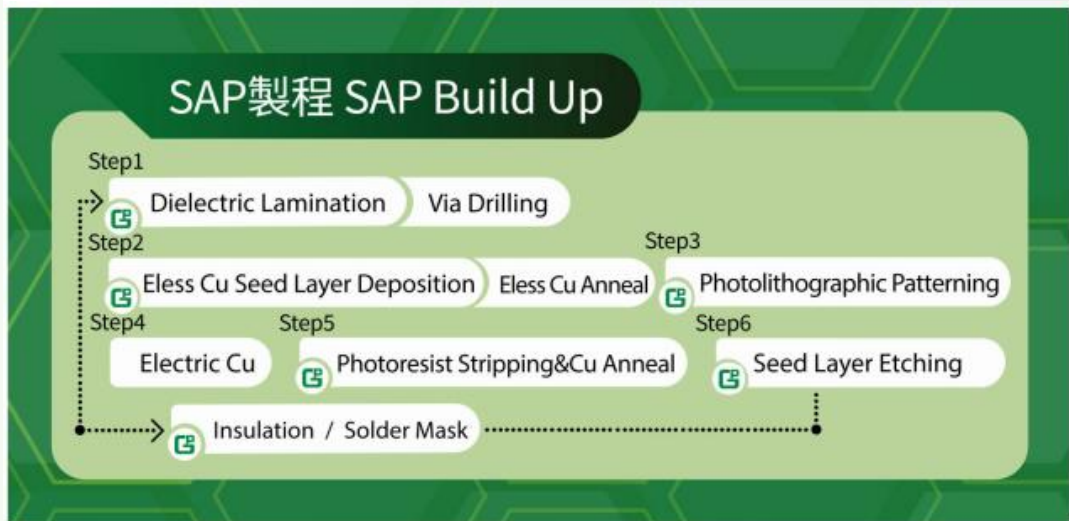
Coater
Dip Coater



Automatic Oven
Various Processes

玻璃核心載板 & 玻璃中介層

TGV 金屬化 + RDL線路增層
塗佈、烘烤、壓膜、撕膜 等
製程設備



Laminator
Dry Film/ABF



Coater
Roller Coater



Automatic Oven
Various Processes



產品銷售實績地理分布

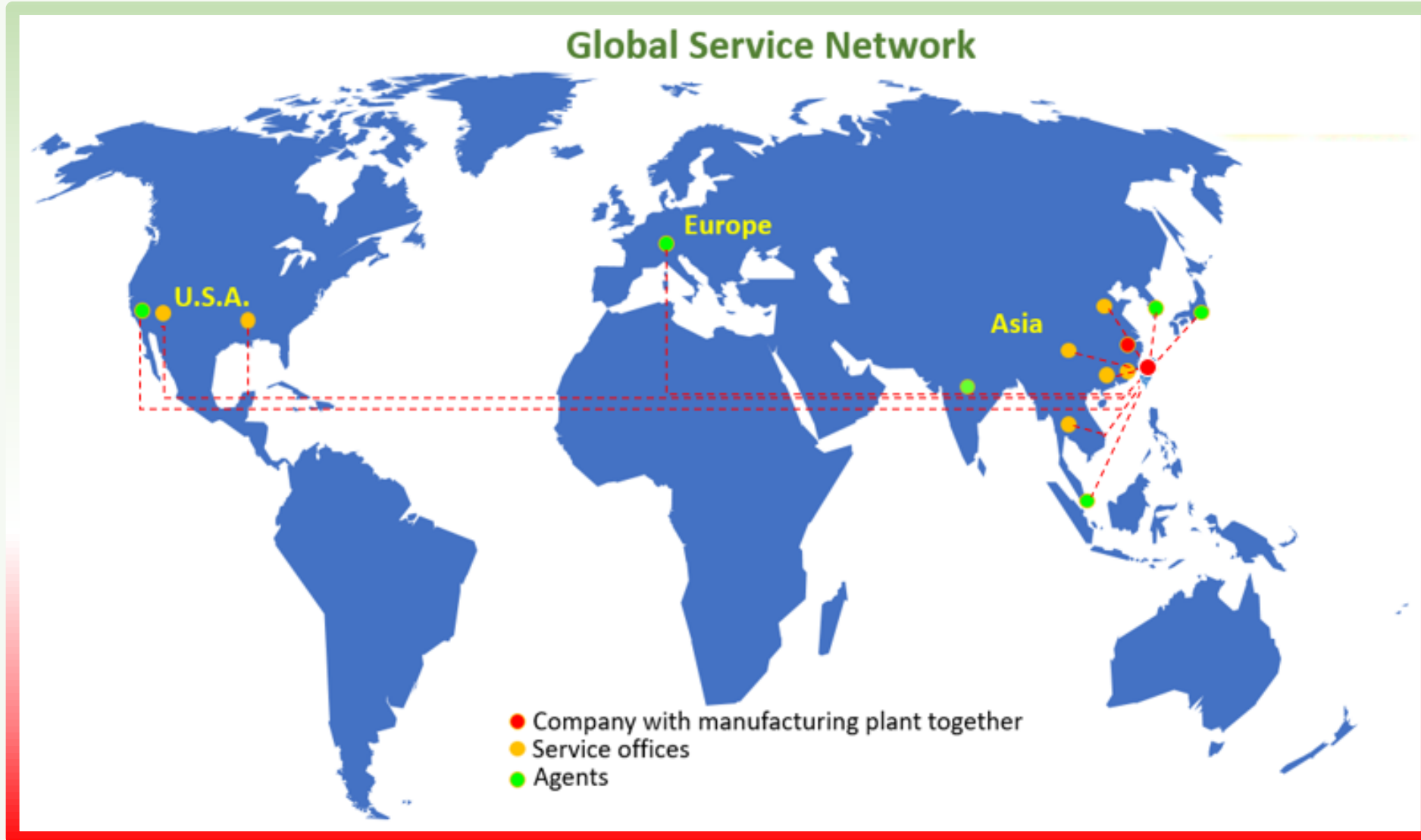


IDM, OSAT, Substrate maker, PCB maker, Display maker...



- wafer
- small panel
- glass core panel
- CCL core / coreless panel (w/ PCB & IC substrate)
- glass carrier PLP
- metal carrier PLP

服務據點佈局



3 ESG

群翊透過創新的商業力量
追求經濟、社會與環境的永續

TO INNOVATE THE TECHNOLOGY, TO LEAD THE MARKET
TO KEEP EXCELLENT SERVICE, TO EARN TRUST

 群翊
GROUP

 36
Years ANNIVERSARY

No. 188, Heping Road, Yangmei District, Taoyuan City 326
T +886-3-4851536 | www.gp-line.com

管理體系建置近期成果: 低軌衛星供應鏈直接要求

CERTIFICATE

特此授予:
群翊工業股份有限公司
 桃園市楊梅區和平路188號

管理體系符合
ISO 9001:2015

驗證範圍
 PCB, BGA, FPC, COF, LCD, TOUCH PANEL, BACK LIGHT, SOLAR CELL製程生產設備, 包含熱風, 紅外線, 紫外線, 熱板, 塗佈, 壓膜, 曝光等專業製程設備

證書編號: ARES/TW/12311134Q
 證書簽發日期: 2023-11-23
 證書有效日期: 2026-11-22

每次監督審核時間與上次現場審核時間間隔不得超過12個月, 且必須取得ARES發給的監督審核通過證明以確保證書有效性。

批准: *Jia*

格瑞國際驗證有限公司
 337002 桃園市大園區
 大華一街 28 號 4F
 03-275-9666
 www.great-cert.com.tw

群翊工業股份有限公司
 326 桃園市楊梅區和平路 188 號
 已依據以下標準通過評估審查
ISO 45001:2018
 此證明之有效範圍為
 PCB、BGA、FPC、COF、LCD、TOUCH PANEL、BACK LIGHT、SOLAR CELL製程生產設備, 包含熱風、紅外線、紫外線、熱板、塗佈、壓膜、曝光等專業製程設備
 (IAF Code: 19)

發證日期: 2024年12月31日 有效日期: 2027年12月30日

W. J. Chen, Managing Director

格瑞國際驗證有限公司
 337002 桃園市大園區
 大華一街 28 號 4F
 03-275-9666
 www.great-cert.com.tw

群翊工業股份有限公司
 326 桃園市楊梅區和平路 188 號

GREAT Certificate

證書號碼: IAS-OHSMS-24-004

茲證明此組織管理系統
群翊工業股份有限公司
 以此稽核地址
 326 桃園市楊梅區和平路 188 號
 已依據以下標準通過評估審查
ISO 45001:2018
 此證明之有效範圍為
 PCB、BGA、FPC、COF、LCD、TOUCH PANEL、BACK LIGHT、SOLAR CELL製程生產設備, 包含熱風、紅外線、紫外線、熱板、塗佈、壓膜、曝光等專業製程設備
 (IAF Code: 19)

發證日期: 2024年12月31日 有效日期: 2027年12月30日

W. J. Chen, Managing Director

格瑞國際驗證有限公司
 337002 桃園市大園區
 大華一街 28 號 4F
 03-275-9666
 www.great-cert.com.tw

群翊工業股份有限公司
 326 桃園市楊梅區和平路 188 號

格瑞國際驗證有限公司
 GREAT International Certification Co., Ltd.

聲明書編號: Great-GHGR-25-0401

溫室氣體排放與移除查證聲明書
群翊工業股份有限公司

溫室氣體排放和移除的盤查在以下地點進行:
 桃園市楊梅區和平路 188 號
 桃園市楊梅區和平路 111 號 1、2 樓
 桃園市楊梅區和平路 137 號 1、2 樓
 桃園市楊梅區民有路一段 83 號 1、2 樓
 桃園市楊梅區民豐路 12 號 2、3 樓

已根據 ISO 14064-3:2019 於 2025 年 03 月 26 日、04 月 01 日進行查證, 符合以下標準要求:
ISO 14064-1:2018

溫室氣體排放資訊:
 直接排放(類別 1): 146.1281 噸二氧化碳當量;
 間接排放(類別 2): 437.0034 噸二氧化碳當量;
 其他間接排放類別(類別 3~類別 6)將於下一頁面表列。

- 查證目標: 格瑞以獨立第三方立場, 公正客觀地收集、查證支持溫室氣體主體所揭露之資訊, 確保報告資訊符合準確性、完整性、一致性及透明度之準則, 且內容無錯誤或遺漏之處。
- 報單期間: 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。
- 類別 1 和類別 2 以合理保證等級進行查證, 類別 3 至類別 6 以有限保證等級進行查證。
- 不確定性評估: -7.07%~+7.07% (95%信心水準, 真實性: 5%)。

總經理 陳文俊
 首次發行日期: 2025 年 04 月 23 日; 最新發布日期: 2025 年 04 月 23 日

afaq
 AFNOR CERTIFICATION

Certificat
 Certificate

N° 2026/117302.1

AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:
 AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :

GROUP UP INDUSTRIAL CO., LTD.
 群翊工業股份有限公司

for the following activities:
 pour les activités suivantes :

THE IT DEPARTMENT IS RESPONSIBLE FOR ERP SYSTEM ADMINISTRATION, DATA CENTER OPERATIONS, AND NETWORK MANAGEMENT WITHIN THE ISMS SCOPE. THIS IS IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF APPLICABILITY, VERSION A, DATED OCT. 1, 2025.
 資訊單位提供 ERP 系統管理與維護, 以及機房與網路管理。
 依據適用性聲明書, 版次: A, 發行日期: 2025 年 10 月 01 日。

has been assessed and found to meet the requirements of:
 a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :

ISO/IEC 27001:2022 (International) - NF EN ISO/IEC 27001:2023 (Europe)

and is developed on the following locations:
 et est développé sur les sites suivants :

NO. 188, HEPING RD., YANGMEI DIST., TAOYUAN CITY 326003, TAIWAN (R.O.C.)
 326003 桃園市楊梅區和平路 188 號

This certificate is valid from (year/month/day)
 Ce certificat est valide à compter de (année/mois/jour)

2026-03-17 Unité Juridique 2029-03-16

Julien NIZRI
 Managing Director of AFNOR Certification
 Directeur Général d'AFNOR Certification

11 rue Francis de Pressensac - 93071 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T: +33 (0)1 41 02 00 00 - F: +33 (0)1 48 17 40 00
 SAS au capital de 18 137 000 € - 475 076 052 RCS Nanterre - www.afnor.com



因應AI與先進封裝用電趨勢：強化組織整廠韌性

- 屋頂型**太陽能**、雨水**回收**裝置
- 自發自用取得**碳權**

- 逐步導入建置ISO50001能源管理系統
- 工廠智慧化能源管理、耗能設備監測



擴大產學合作 因應新廠招募 人才永續佈局

- 國立台灣大學國際事務處
- 第五屆國際引路人計畫合作
- 國立中央大學
- 第九屆企業導師計畫
- 國立陽明交通大學
- 電子科技校園徵才

機電與科技產業
Electronics & Technology

! New Partner Organizations!!

職涯發展中心 114-2
第九屆企業導師計畫

#新新陣容 #優質專業
#客製化輔導 #經驗傳承 #學習加乘

01. 計畫宗旨
由中央大學校友、企業高階主管、產業專家或具有輔導證照擔任「專屬mentor」，帶領學生探索職涯方向、突破學習瓶頸、培養職場軟硬實力

02. 參加對象
不分年級/系所皆可申請
若人數過多，將以研究生及大學部三、四年級為優先。
(當學年已有出國交換計劃者不得申請)

03. 導師活動規劃
自我探索
性向分析
小組/跨組討論
小組/跨組交流
產業認識

04. 例行活動
職涯分享
企業參訪
專案實作
履歷健檢
模擬面試

04. 例行活動
期初師徒見面會
各組導師活動規劃
期末成果展

Cake

2026 半導體電子科技徵才博覽會

Tech Career Fair

02.07
10:00 — 16:00

新竹 / Hsinchu
陽明交通大學新竹博愛校區 賢齊館
NYCU Boai Campus Bio-ICT Building

美中參展擴人脈 特殊基板承載裝置專利展先機



I919878



(19) 中華民國智慧財產局

(12) 發明說明書公告本

(11) 證書號數：TW I919878 B

(45) 公告日：中華民國 115 (2026) 年 03 月 21 日

(21) 申請案號：114115450

(22) 申請日：中華民國 114 (2025) 年 04 月 24 日

(51) Int. Cl.: H10P72/70 (2026.01)

(71) 申請人：群翊工業股份有限公司 (中華民國) GROUP UP INDUSTRIAL CO., LTD. (TW)
桃園市楊梅區和平路 188 號

(72) 發明人：陳安順 CHEN, AN-SHUN (TW)

(74) 代理人：張耀暉；莊志強

(56) 參考文獻：

TW M672003U

TW 202341240A

審查人員：孫建文

申請專利範圍項數：9 項 圖式數：10 共 27 頁

(54) 名稱

基板承載裝置

連結桃園永續領導力 實踐公益 提升品牌價值





Thank you

Any Questions Feel free to contact us
gp@gpline.com.tw



www.gpline.com.tw